

证券代码：301678

证券简称：新恒汇

新恒汇电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	方正证券 王海维 中邮创业基金 姚婷
时间	2026年1月14日
地点	线上
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 张建东 证券事务代表 宗晓艳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司董事会秘书张建东先生就公司生产经营情况进行介绍。</p> <p>二、调研的主要问题：</p> <p>1、eSIM 芯片封测、蚀刻引线框架市场竞争格局情况？</p> <p>回复：目前，公司在物联网 eSIM 芯片封测领域主要提供 DFN/QFN 封装、MP 卡封装等产品或服务，主要是可穿戴设备、物联网消费电子、工业物联网等领域。鉴于物联网 eSIM 芯片封测属于非常细分的业务领域，通过公开渠道查询，尚无权威的可比公司资料。</p> <p>蚀刻引线框架领域，中国大陆生产厂商基础较为薄弱，产能受生产设备及技术工艺制约，仍在爬坡。境内</p>

只有少数企业可以批量供货，产能存较明显缺口。

在中美半导体贸易摩擦和国家对集成电路行业大力扶持的政策下，高端封装材料国产替代势在必行，为国内蚀刻引线框架企业提供了广阔的发展空间。而新恒汇与国际行业头部企业相比，在经营规模和产品类别方面存在差异。但与国内同行业其他厂家相比，公司技术水平具有领先优势，产能位居行业前列。预计未来一段时间受到整个行业上升及国产替代趋势推动，市场发展空间较大。

2、公司蚀刻引线框架产品布局和市场需求？

回复：公司打造了 CuAg、PPF、Flip Chip 系列引线框架产品阵列，未来将持续升级并推出系列化车规级引线框架产品，在消费电子芯片封装、物联网芯片封装、汽车电子芯片封装、工业控制芯片封装四大核心领域协同发展，构筑行业综合竞争能力。

公司深化上游供应商的战略合作，聚焦大颗粒、长引脚、高密度的高端产品，实现产品结构调整；持续提高技术工艺研发能力，采用新工艺、开发新产品，丰富产品线，积极布局国产材料产品研发和产业化准备，努力将公司发展成为全球一流的蚀刻引线框架供应商。

随着 5G 通信、人工智能、物联网、汽车电子等新兴领域的快速发展，对集成电路的需求将持续增长，封测市场也随之受益。在集成电路国产化加速的背景下，公司加快实施高密度 QFN/DFN 封装材料产业化项目，产能进一步提升，保障产品的交付，争取更高市场份额。

3、未来 3-5 年公司的战略规划？

回复：未来三年，公司围绕智能卡业务、蚀刻引线框架业务和物联网 eSIM 芯片封测三大业务板块，以持续技术创新、业务创新为核心，努力提高市场品牌知名

	度，拓宽市场优质客户群为重点，延伸并深化公司现有业务，提升公司盈利能力，提高公司综合竞争实力。加强营销团队建设，扩大国际市场品牌知名度，推动新产品在客户中的认证，扩展现有客户的产品合作深度，并积极开拓新客户、新领域，尤其是海外客户，以求在行业内取得更大的市场份额，为股东创造更大价值。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 1 月 14 日